证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2026-088

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于首次回购股份及回购实施完成暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2026/11/23
回购方案实施期限	2026 年 11 月 22 日~2027 年 5 月 21 日
预计回购金额	0.5亿元~1亿元
回购价格上限	230元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	528,100股
实际回购股数占总股本比例	0.61%
实际回购金额	9,957.83万元
实际回购价格区间	181.39元/股~197.99元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含），回购价格不超过人民币 230 元/股（含），本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-086）。

二、 回购实施情况

（一）2026 年 11 月 23 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 528,100 股，占公司总股本的 0.61%，回购最高价格 197.99 元/股，回购最低价格 181.39 元/股，回购均价 188.56 元/股，使用资金总额 99,578,282.65 元（不含交易费用）。

（二）截至 2026 年 11 月 23 日，公司本次回购通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 528,100 股，占公司总股本的 0.61%，回购最高价格 197.99 元/股，回购最低价格 181.39 元/股，回购均价 188.56 元/股，使用资金总额 99,578,282.65 元（不含交易费用）。公司本次回购资金总额已达回购方案下限且未超过回购方案上限，本次回购方案实施完毕。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购不会对公司日常生产经营、财务状况、债务履行能力、盈利能力和未来发展产生重大不利影响。本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

经核查，自公司首次披露回购股份事项之日起至披露本公告前一日期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	87,000,000	100.00	87,000,000	100.00
其中：回购专用证券账户	383,800	0.44	911,900	1.05
股份总数	87,000,000	100.00	87,000,000	100.00

五、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 528,100 股，本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励的用途。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分应予以注销，如相关法律法规作出调整，则按调整后的规则执行，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日